

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于设立日本全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为更好地服务于公司战略发展规划需求、进一步巩固公司在泛半导体洗净领域的竞争优势，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在日本投资设立全资子公司（以下简称“本项投资”），拟投资金额为人民币6,360.00万元。

公司于2023年6月8日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立日本全资子公司的议案》，根据相关规定，本项投资无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

公司本次向境外投资并设立全资子公司，需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。

二、本项投资的基本情况

1、公司名称：富乐德(日本)科技发展有限公司（该名称为暂定名，最终名称以核准名称为准）

2、项目建设地：日本熊本县

3、投资额：人民币6,360.00万元

4、出资方式：货币资金，以自有资金出资

5、股权结构：公司持有100%股权

6、经营范围：泛半导体行业精密洗净及衍生增值服务

以上信息以工商行政管理部门及有权管理部门的核准为准。

三、本项投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、目的

(1)完善业务布局、满足公司战略发展的需要

精密洗净与再生处理服务具有显著的服务半径，因此行业内企业均围绕下游晶圆代工和显示面板制造等客户生产线配套建设相应的洗净服务基地。公司成立至今，业务已经拓展到天津、大连、内江、铜陵、上海、广州6大业务基地，覆盖国内北方、西南、华东、华南四大区域。而随着全球各国大力发展本土芯片生产，以及下游客户扩产计划的推进，公司亦面临全球化业务布局的客观战略需求。

2021年11月，日本政府制定了7,740亿日元（约385亿元人民币）的特别内阁预算，其中6,170亿日元成立半导体基金，用于资助高端芯片制造投资；470亿日元用于资助模拟芯片投资；1,100亿日元用于其他芯片和电源管理组件投资。该补贴计划从2022年3月开始实行。2021年11月，在获得日本政府补贴承诺的前提下，台积电宣布与索尼合资在日本新建一座12英寸晶圆厂。该晶圆厂初期将采用22nm至28nm工艺制程，预计2022年动工、2024年底前投产，月产能可达4.5万片12英寸晶圆。根据国际半导体产业协会（SEMI）的数据，日本明年预计将在晶圆厂设备上投入70亿美元，较今年增长82%，增幅位居全球之首。另根据日本经济产业省预估，日本半导体产业的市场总体规模将从2020年的约50兆日元（2.55兆人民币），增长到2025年的约75兆日元（约合3.82兆人民币），再到2030年约100兆日元（约合5.1兆人民币），将覆盖智慧城市、自动驾驶、智能家电、数据中心、手机、电脑等领域。因此，公司有必要跟随下游晶圆代工行业发展趋势，于日本新建精密洗净及再生服务基地，完善业务区域布局，以实现全球化业务布局的战略发展需求。

(2)实现业务升级，为业务持续增长奠定坚实基础

随着全球各国不断大力发展本土芯片生产，全球晶圆代工产业产能分布趋于分散。此外，精密洗净服务行业各类客户不再局限于基本的洗净需求，设备维修、陶瓷熔射等洗净增值服务需求势必增加，同时洗净服务内容需求呈现个性化和多样化趋势。本次项目通过全面深化与主机厂（AMAT，AM，TEL等）的合作，辅以公司间接控股股东日本磁控的业务线和客户资源优势，积极开拓日本泛半导体精

密洗净市场，项目实施后，公司将完成按照洗净行业经营特点进行的日本服务基地布局，项目的实施将促进公司洗净及衍生增值服务业务的大规模增长，为公司未来业务的持续增长奠定坚实基础，进一步巩固公司在泛半导体洗净领域的竞争优势。

(3) 助力公司品牌影响力和市场占有率的进一步提升

目前，公司的洗净及再生业务的主要客户包括英特尔、台积电、中芯国际、华虹半导体、三星电子、京东方、华星光电、深天马等主流晶圆代工和显示面板制造企业，在行业内具有较强的行业知名度和影响力。但是，同欧美、日、韩等国际领先洗净及再生服务厂商相比，公司在洗净及再生服务工艺、制程覆盖范围、品牌影响力方面都存在进一步提升的空间。

本项目的实施通过本土化服务于日本客户群体，巩固现有客户群体市场份额的同时，不断开拓新的目标客户，将促进公司洗净及再生服务和品牌在日本的宣传和推广，提升公司品牌形象的广度和深度，增强本地客户的信任度和认同感，同时积极探索洗净增值服务，助力公司品牌影响力和市场占有率的进一步提升。

2、对公司的影响

(1) 公司的产品研发技术实力为项目实施奠定了技术基础

公司通过20余年的洗净及再生行业经验积累，掌握了包括微污染检测控制技术、高制程IMPLANT石墨清洗再生技术、等离子陶瓷涂层加工技术、半导体28/14纳米制程PVD部品清洗再生技术、OLED显示蒸镀设备清洗技术等在内的洗净及再生领域核心技术。公司拥有两条高级别试验线用来研发新产品精密清洗技术，拥有国家首条高纯石英精密清洗线，用来研发EPI等高纯度材料精密清洗技术；拥有class100级精密清洗试验线及class10级取样系统以开发高级别部件精密清洗技术。

长期以来，公司的洗净技术的更新与国内客户高阶制程的进步基本保持同步，始终保持在国内精密洗净先进工艺的前列。公司自主研发的10nm及以下半导体制程精密洗净技术成功量产应用于全球知名半导体公司，自主研发的10.5代LCD及6.5代OLED精密清洗技术，多年服务于BOE, 熊猫，天马等国家重点面板企业。雄厚的产品研发技术实力为项目实施奠定了技术基础。

(2) 丰富的产品平台和品牌优势

公司是国内较早进入精密洗净及再生领域的企业，20余年来长期专注于半导

体和面板显示生产设备再生式精密洗净，为客户生产设备污染控制提供清洗整体解决方案。公司业已发展成为国内具备显著规模、服务覆盖范围优势的洗净及再生服务提供商。依托精密洗净平台，公司完善的产品体系可以满足下游客户的多样化需求，公司以提供优质的产品和服务在下游集成电路晶圆代工和显示面板制造领域树立了优质品牌形象，客户涵盖英特尔、台积电、中芯国际、华虹半导体、三星电子、京东方、华星光电、深天马等主流晶圆代工和显示面板制造企业。作为国内领先的洗净及再生服务提供商，公司相关洗净及再生产品具有显著的品牌效应。

本次项目是基于现有洗净工艺和客户群体的延伸，符合下游半导体和显示行业对洗净及再生增值服务日益增多的发展趋势，公司丰富的产品平台和品牌优势使得本项目具备较强可行性。

(3) 公司具备丰富的服务经验和完善的质量管理体系

随着公司业务涉及的专业领域和区域的不断拓展，以及客户对于产品质量的要求持续提高，对公司整体的产品质量管控能力提出了更高的要求。公司高度重视产品的质量管理，设立品质部，由其负责组织制定和完善各项质量管理制度，对公司入厂原材料、产品生产过程和产品质量进行检验、记录、统计、分析，建立质量管理档案。公司按照ISO9001质量管理体系标准的要求，并结合公司的产品生产特点，制定了一系列质量管理体系程序文件，涉及各项质量标准及检验规范、各项质量标准及检验规范、各项质量标准及检验规范、售后服务与质量改进、不合格品控制、不合格品控制，明确了各道工序的质量标准与各部门人员的职责，使质量管理工作贯穿公司生产经营的全过程。

在服务经验方面，自2000年开始从事精密洗净事业以来，公司业务已经拓展到天津、大连、内江、铜陵、上海、广州6大业务基地，其中3家工厂拥有16nm及以下制程高规格洗净线。丰富的项目实施和服务经验为本次项目实施奠定了良好的经验基础。

(4) 公司与下游客户及及半导体设备厂商建立了良好的业务关系

自成立以来，公司一直致力于为半导体和面板显示生产设备进行再生式精密洗净，为客户生产设备污染控制提供清洗整体解决方案。公司业务覆盖范围广，能满足下游晶圆代工和显示面板生产企业不同尺寸、制程的需求，公司业已发展为国内泛半导体精密洗净领域的领先企业，不断地推动精密洗净事业在中国的发

展。

公司与下游晶圆代工企业、显示面板制造企业建立起了广泛业务合作关系，客户涵盖英特尔、台积电、中芯国际、华虹半导体、三星电子、京东方、华星光电、深天马等主流晶圆代工和显示面板制造企业。同时，公司还与AMAT、LamResearch、ULVAC、TEL、TOKKI、KOK等全球知名半导体设备厂商建立了广泛的业务合作关系。公司与下游晶圆代工企业、显示面板制造企业以及半导体设备厂商建立起来的良好业务合作关系有助于本次项目顺利实施。

3、存在的风险及应对措施

(1) 市场拓展风险

精密洗净与再生处理服务具有显著的服务半径，因此行业内企业均围绕下游晶圆代工和显示面板制造等客户生产线配套建设相应的洗净服务基地。目前公司工厂包括上海、大连、天津、安徽、四川和广州，基本覆盖了中国大陆地区的主要客户区域，在国内半导体和显示面板设备精密洗净服务领域具有显著竞争优势。随着全球各国大力发展本土芯片生产，以及下游客户扩产计划的推进，公司逐步布局海外市场，于日本新建精密洗净及再生服务基地，完善业务区域布局，以实现全球化业务布局的战略发展需求。

向新区域拓展需要资金和人员投入，也会涉及新的风险和挑战。虽然公司与众多优质晶圆代工企业、显示面板制造企业建立了稳定而广泛的合作关系，但面对新进入的市场，公司可能存在短期内无法进入重要目标客户供应体系，市场拓展不及预期，从而导致投资项目无法实现预期收益。

控制措施：公司在维持现有市场份额和客户的同时，加大潜在客户的开发力度，通过品质良好的洗净服务，取得其对公司技术和服务的认可，以树立公司的市场声誉；凭借在行业取得的良好业绩和声誉，进而持续开拓泛半导体行业新兴区域市场。此外，公司将在技术储备、产品布局、检测质量、客户认证、销售与服务等方面持续提升，力争在新的市场竞争中处于有利地位。

(2) 技术和生产风险

提高性能、降低能耗是半导体行业技术演进的主题，新一代半导体技术的关键衡量标准之一是一个芯片上可以封装多少个晶体管（电子开关），这取决于芯片的尺寸大小。半导体技术的发展包括：更密集且更复杂的芯片、更小的器件（即“工艺节点”）、3D特性（处理器垂直而非水平堆叠，从而在更小的空间内实现

更强的性能)、更大的晶圆(每个晶圆的芯片更多)。而随着技术节点的不断缩小,芯片制造需要在更严格的洁净室环境下进行,半导体制造商需进一步严格规范进入工厂的污染物,在对公司所提供的精密洗净服务需求不断增加的同时,对设备清洗表面污染物的种类、清洗效率、洁净度等提出更高要求。如果公司未来不能紧随行业技术发展趋势,不断更新升级洗净技术和工艺,公司洗净服务无法持续满足客户需求,公司竞争力和市场份额有可能下降,从而影响公司可持续发展。

控制措施:公司将持续加大技术开发和自主创新力度,积极引入材料、化学、微电子、机械等多领域人才,强化人才储备,坚持需求型研发和前瞻型研发并举,通过积极与客户合作研发,紧跟市场需求和世界科技前沿,加强新技术在本行业的深度应用,挖掘和提炼洗净技术,持续巩固并提升公司技术自主研发能力。同时,公司持续推动产学研结合,深度参与半导体领域的技术开发,提升清洗服务技术水平、质量和可靠性,持续保持公司技术的领先性。

(3) 人力资源和管理风险

公司目前已建立了较完善的法人治理结构和企业管理制度,运行状况良好。但随着本次项目实施,经营规模和生产能力大幅度增长,公司面临的经营环境也日趋复杂,要求公司能对市场的需求和变化做出快速反应,对公司现金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理 etc 管理能力的要求也随之提高。因此,公司面临一定的管理风险。此外,公司实施本项目后对技术人才、管理人才等专业人才的需求将大量增加。人才是现代企业生存与发展的根本,生产技术、管理和营销人才对公司发展至关重要。公司面临人才吸引、保留和发展的风险。

控制措施:随着公司的不断发展壮大,公司将根据业务发展和内部机构调整的需要,及时完善和补充内部管理制度,提高内部管理制度的可操作性,使其更好的发挥在公司生产经营中的促进、监督、制约作用。因此,公司管理风险较小。公司管理层高度重视人才在公司发展中的作用,将继续加强员工招聘、培训、考核、企业文化建设,继续抓好人才内部培养与外部引进相结合工作,不断完善人才激励与约束机制,积极从事业、待遇、归属感三方面培养公司自己的人才。公司将相继制定相关人力资源政策,以适应公司对人才的需求,满足公司快速发展的需要。

(4) 政治、安全、自然灾害风险

项目所在地日本政治稳定、法治相对健全，享有良好的商业环境和稳定的政策框架。政府亦一直致力于吸引外国投资和提供支持，设立公司的程序相对简化，法律保护措施健全，许多国际企业在日本蓬勃发展。此外，日本也是一个安全的国家，犯罪率相对较低，社会秩序良好。该国的法律制度和司法体系高效，为企业提供了安全感。尽管如此，仍应意识到日本存在一些潜在的政治和安全风险。例如，日本政府可能对某些行业或特定企业实施监管或限制措施。

此外，日本地震和台风等自然灾害也可能对公司业务造成一定程度的影响。项目生产经营地在日本熊本县，公司生产场地及其周边地区若发生自然灾害，可能造成生产场地建筑及设施的损坏，给公司带来直接损失。同时，自然灾害所导致的通讯、电力、交通中断，生产设施、设备的损坏，也会给公司的生产经营造成不利影响。

公司进行合理设计房屋结构和布局，并通过设立预警机制，树立风险防范意识，制订风险综合管理制度和应急预案，同时加强网络安全措施，建立支持大规模灾害准备的BCP措施来最小化自然灾害的风险，确保公司业务的持续运作。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2023年06月09日